電子機器2022 トータルソリューション展

一歩先の未来へ　来て　見て　触れて　そして　語ろう！

6.15 Wed. → 6.17 Fri.　10:00-17:00

東京ビッグサイト 東4-6ホール+会議棟

完全WEB登録制 **事前登録** **パッと登録！パッと入場！**

事前登録のうえ、来場者バッジを出力しお持ちいただいた方は、当日会場内設置のバッジホルダーをピックアップいただくだけでスムーズにご入場いただけます。

来場登録はこちらの WEBから
▶www.jpcashow.com/

招待状　入場料：1,000円（税込）WEB登録にて無料

www.jpcashow.com

開催概要

- JPCA Show 2022 第51回国際電子回路産業展　主催：一般社団法人日本電子回路工業会
- JIEP マイクロエレクトロニクスショー 第36回 最先端実装技術・パッケージング展　主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会
- JISSO PROTEC 2022 第23回 実装プロセステクノロジー展　主催：一般社団法人日本ロボット工業会
- SDGsデバイス展　共催：一般社団法人日本電子回路工業会／電子デバイス産業新聞（（株）産業タイムズ社）
- WIRE Japan Show 電気・光伝送技術展　共催：一般社団法人日本電子回路工業会／電線新聞（（株）工業通信）
- JEP/TEP Show　JEP 全国電子部品流通連合会／東京都電機卸商業協同組合　共催：一般社団法人日本電子回路工業会／全国電子部品流通連合会／東京都電機卸商業協同組合
- E-Textile イーテキスタイル展　共催：一般社団法人日本電子回路工業会／株式会社繊研新聞社
- Smart Sensing スマートセンシング　共催：一般社団法人日本電子回路工業会／株式会社JTBコミュニケーションデザイン
- INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION interOpto インターオプト　主催：一般財団法人光産業技術振興協会　企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
- LED JAPAN エルイーディージャパン　共催：一般社団法人日本電子回路工業会／株式会社JTBコミュニケーションデザイン
- Imaging Japan イメージングジャパン　共催：一般社団法人日本電子回路工業会／株式会社JTBコミュニケーションデザイン
- Edge Computing エッジコンピューティング　共催：一般社団法人日本電子回路工業会／株式会社JTBコミュニケーションデザイン

会　　期：**2022年6月15日（水）～17日（金）** 10:00～17:00
会　　場：**東京ビッグサイト　東4-6ホール＋会議棟**
入　場　料：1,000円（税込）※招待券持参者及びWEB登録で無料
本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会
運営事務局：㈱JTBコミュニケーションデザイン
後　　援：経済産業省（予定）

海外協力：世界電子回路業界団体協議会（WECC）加盟団体：
CPCA（中国電子電路行業協会）、EIPC（欧州電子回路協会）、
ELCINA（印度電子工業会）、HKPCA（香港線路板協会）、
IPC（米国電子回路協会）、IPCA（印度電子回路工業会）、
KPCA（韓国電子回路産業協会）、THPCA（タイ電子回路工業会）、
TPCA（台湾電路板協会）

基調講演　プログラム　有料　VIP 無料

来場事前登録より、聴講申込みください。　**展示ホール A会場**

聴講料：会員※10,000円、非会員 20,000円／1セッション（聴講料は税込です）　※JPCA会員／JIEP正会員・賛助会員／JARA正会員・賛助法人会員／JEP・TEP正会員

	6月15日（水）	6月16日（木）	6月17日（金）
	SDGs電子デバイス	E-Textile／ウェアラブル	医療／FLEX基板（脳波・アルツハイマ）
10:45～11:30	3000兆円投資のSDGs革命、メタバースが電子デバイスに一大インパクト 泉谷 渉　㈱産業タイムズ社　代表取締役会長	新たな実装技術で創るフレキシブルデバイス「インモールド・フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス（iFHE）」 福島 誉史　東北大学　大学院工学研究科　機械機能創成専攻　准教授	伸縮自在なエレクトロニクスで創る「脳波AI解析ツール」 関谷 毅　大阪大学　産業科学研究所　教授
	IoT/スマートシティー	自動車	半導体生産
11:45～12:30	都市間連携でデータを共有するスマートシティの未来～MCSCCの活動紹介～ 豊崎 禎久　（一社）サイバースマートシティ創造協議会　代表理事	カーボンニュートラルに向けた自動車の電動化の最新動向 大仲 英巳　技術研究組合 FC-Cubic　専務理事	東京大学の産学連携最前線～半導体強化およびDX推進～ 染谷 隆夫　東京大学　工学部長、大学院工学系研究科長
	パワーエレ／実装	スマホ／内蔵カメラ	カーボンニュートラル
13:30～14:15	パワー半導体の将来展望 パワー半導体が支える日本の未来像 岩上 徹　三菱電機㈱　パワーデバイス製作所　所長	すべてがつながったインテリジェントな世界へ 張 松梅　華為技術日本㈱　渉外広報本部　担当部長	川崎重工グループの水素サプライチェーン構築の取り組み 橋本 康彦　川崎重工業㈱　代表取締役社長執行役員

ものづくり系YouTuber ものづくり太郎氏によるトークイベント開催決定！　無料　事前登録不要　**展示ホール A会場**

【ものづくり太郎とは?】チャンネル登録数14万件を誇るYouTuber「ものづくり太郎チャンネル」にて検索ください。

6月15日（水） 6月16日（木） 6月17日（金）	14:30-15:15	「ものづくり太郎、日本の電子回路産業を斬る!?」（仮）

JIEP 最先端実装技術シンポジウム　有料　要事前登録　会議棟6階　605+606会議室＜A会場＞及び607+608会議室＜B会場＞

※聴講料は会員区分によって異なります。金額・聴講申込方法は HP よりご確認ください。 **www.jpcashow.com/show2022/**

	Time	A会場	B会場
6月15日（水）		**15A-1** 9:50-12:30	**15B-1** 10:30-12:15
		5G/6Gに対応する基板・材料・プロセス最新動向　座長：松本 博文	
	9:50-10:40	**15A1-1** 高周波に対応する銅配線形成技術　－新シード層を用いた“平滑面”への銅配線の形成 冨士川 亘　DIC㈱　E-2プロジェクト　技術統括マネジャー	
	10:40-11:35	**15A1-2** B5Gを見据えたフッ素系材料の技術・開発動向 細田 朋也　AGC㈱　化学品カンパニー　応用商品開発部　複合材料開発室長	
	11:35-12:30	**15A1-3** 高周波対応・特殊用途のFPC/Semi Flex PWBの採用事例 上田 弘孝　セミコンサルト　代表	
		15A-2 13:35-16:20	**15B-2** 13:35-16:20
		次世代情報処理（AI、IoT等、量子コンピューター）・SDGsも背景にある?　座長：土門 孝彰、齊藤 雅之	3D-ICが見つめる先には、実装技術の挑戦と課題　座長：西田 秀行、小岩 一郎
	13:35-14:30	**15A2-1** 量子コンピューターの開発と導入（仮） 山道 新太郎　日本アイ・ビー・エム㈱	**15B2-1** 次世代ノードの鍵を握る3D集積技術の進化と応用へ向けた取り組み 井上 史大　横浜国立大学　准教授
	14:30-15:25	**15A2-2** Quantum Transformation 量子コンピュータによる社会実装最前線 寺部 雅能　住友商事㈱　Quantum Transformationプロジェクト　プロジェクト代表	**15B2-2** 最先端ダイ / ウェーハレベル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積化 山本 宏　イーヴィグループジャパン㈱　代表取締役
	15:25-16:20	**15A2-3** 量子コンピューター開発におけるシリコン集積化技術の役割 森 貴洋　産業技術総合研究所　デバイス技術研究部門　主任研究員	**15B2-3** Overview and Initiatives of TSMC Japan 3DIC R&D Center（仮） 市川 公也　TSMCジャパン3DIC研究開発センター㈱　Technical Director
6月16日（木）		**16A-1** 9:45-12:30	**16B-1** 9:45-12:30
		5G・6G通信端末市場と実装技術動向　座長：猪川 幸司、越地 福朗	DX社会実現に向けて、、、半導体産業復活はあり得るのか?何ができるか、何をなすべきか　座長：西田 秀行、内木場 文男
	9:45-10:40	**16A1-1** 5G・6G通信端末市場と対応デバイス・実装技術動向 清水田 大典　㈱富士キメラ総研	**16B1-1**（仮）日本半導体産業の復興なんて幻想だ 湯之上 隆　微細加工研究所　CEO兼所長
	10:40-11:35	**16A1-2** 5Gスマートフォンに見る半導体パッケージとその実装技術の動向 上田 弘孝　セミコンサルト　代表	**16B1-2** パッケージ市場での日本の強みと今後のビジネスチャンス（仮） 亀和田 忠司　AZ Supply Chain Solutions
	11:35-12:30	**16A1-3**（仮）次世代パッケージ F OLP ® の特徴と適用市場 鈴木 敬史　アオイ電子㈱　第1 技術本部 FOLP 事業部　部長代理	**16B1-3** 半導体産業の変貌と今後の展開 ～海外から学ぶニッポン復活のシナリオ 津田 健二　国際技術ジャーナリスト兼セミコンポータル編集長
		16A-2 13:35-16:20	**16B-2** 13:35-16:20
		CASEに向けた車載機器実装技術の最新動向　座長：三宅 敏広、池田 浩昭	SDGs・カーボンニュートラル　座長：土門 孝彰、渡邉 裕彦
	13:35-14:30	**16A2-1** 日米中欧の分解から読み解く2025年のEV像とそこに求められるパワーエレクトロニクス実装技術最前線 山本 真義　名古屋大学　未来材料・システム研究所　教授	**16B2-1** カーボンニュートラル社会実現に向けた取組み 大原 雄治　㈱IHI　資源・エネルギー・環境事業領域 カーボンソリューションSBU　技術センター　次長
	14:30-15:25	**16A2-2** ワイドギャップ半導体向けパワーモジュール技術開発 杉木 昭雄　大分デバイステクノロジー㈱　開発部　部長	**16B2-2** 新たな成長期に入ったエレクトロニクス / 半導体市況展望 ～ポストコロナで加速するDX、GX、メタバースで半導体産業成長シナリオが変わる～ 南川 明　インフォーマインテリジェンス合同　コンサルティンググループ　シニアコンサルティングディレクター
	15:25-16:20	**16A2-3** 自動運転レベル3時代の車載センサ技術の動向 上田 弘孝　セミコンサルト　代表	**16B2-3** カーボンニュートラルの実現に向けた新戦略 末吉 光太郎　㈱みずほフィナンシャルグループ　法人業務部サステナブルビジネス企画チーム　次長
6月17日（金）		**17A-1** 9:45-12:30	**17B-1** 9:45-12:30
		新たな配線・実装がもたらすスマート衣料最前線（案）　座長：本多 進、小岩 一郎	e-Axleと電池　座長：三宅 敏広、土門 孝彰
	9:45-10:15	**17A1-1** 衣服型ウェアラブルデバイスの開発史から読み解くE-テキスタイル、スマートテキスタイルの今後の開発課題 前田 郷司　東洋紡㈱　総合研究所　主幹	9:45-10:40 **17B1-1** eAxle（イーアクスル）の最新動向（仮） 高澤 里美　㈱産業タイムズ社　電子デバイス産業新聞　編集部　記者
	10:15-11:05	**17A1-2** 女子大工学部で取り組むプリンタブル／ウェアラブルなシステムの研究 才脇 直樹　奈良女子大学研究院　工学系　教授／大阪大学大学院　基礎工学研究科　特任教授	10:40-11:35 **17B1-2** 自動車エレクトロニクス技術動向 ～電気自動車と自律運動に向けて～ 宇都宮 久修　インターコネクション・テクノロジーズ㈱　代表取締役
	11:05-11:55	**17A1-3** e-テキスタイル、導電糸とは?（仮） 笹山 秀樹　福井工業技術センター　新産業創出研究部 ウェアラブル技術研究グループ　主任研究員	
	11:55-12:30	**17A1-4** 衣服ウェアラブルデバイスによるバイタルセンシング ～ 心電データから心身状態はどこまで読み解けるか? ～ 前田 郷司　東洋紡㈱　総合研究所　主幹	11:35-12:30 **17B1-3** 全固体電池の最新動向（仮題） 一杉 太郎　東京大学　理学系研究科化学専攻　教授
		17A-2 13:35-16:20	**17B-2** 13:35-16:20
		車載機器の高密度実装化に向けて　座長：猪川 幸司、和嶋 元世	Beyond5Gへの挑戦、新しい実装技術への取り組みとソリューションの提案　座長：西田 秀行
	13:35-14:30	**17A2-1** オートパイロット型統合ECUに見る実装技術 清水 洋二　㈱テカナリエ	**17B2-1** 半導体産業のこれからを担う3D-IC実装技術の現状と課題、アカデミアからの提案 福島 誉史　東北大学　大学院工学研究科　機械機能創成専攻　准教授
	14:30-15:25	**17A2-2** 車載E/Eアーキテクチャーの進化に向けたECU実装構造とプリント配線板技術 戸田 光昭　㈱メイコー　先行開発マーケティング部　部長	**17B2-2** 実装技術の変遷と今後の展望 晴 孝志　東レエンジニアリング㈱　第一事業部開発部　チームリーダー
	15:25-16:20	**17A2-3** 微細化するビルドアップ基板マイクロビアの信頼性問題 菅沼 克昭　大阪大学　フレキシブル3D実装協働研究所　特任教授・所長	**17B2-3** 企業連携による半導体パッケージ評価プラットフォーム（JOINT2） 満倉 一行　昭和電工マテリアルズ㈱　パッケージングソリューションセンタ　主任研究員

ダントツものづくりセミナー　無料　事前登録不要　**展示ホール B会場**

6月15日（水）		6月16日（木）		6月17日（金）	
13:00-13:45	【特別講演1】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション 岸良 裕司　ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン　CEO	13:00-14:00	ものづくりにおける改善とは? リードタイム短縮化方法 鈴村 尚久　エフ・ピー・エム研究所代表取締役／トヨタ生産方式コンサルタント	13:00-14:00	【特別講演5】生産性向上に向けたデジタル化によるロスゼロ生産 福田 好朗　法政大学名誉教授／一社）Lean MONOZUKURI Network Japan副代表理事
13:45-14:30	【特別講演2】月曜日が楽しみな会社にしよう！ ～全体最適のマネジメント理論TOCとは～ 岸良 裕司　ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン　CEO	14:00-14:40	【基調講演】JPCAものづくり大賞5周年 ～受賞概要と変遷～（初の公開報告） 山本 治彦　JPCA副会長／JPCAものづくりアカデミー校長／E-ESMAP研究会代表幹事	14:00-14:45	【特別講演6】経営者に見える現場改善効果「現場改善会計（GKC）」 柊 紫乃　愛知工業大学経営学部経営学科　教授
14:30-15:30	品質経営の取り組み方（シックスシグマ品質） アイリス Xin Liu（劉昕）　マスターブラックベルト	14:40-15:10	JPCAものづくり大賞受賞改善取組み 事例報告 川島 満　第2回JPCAものづくり大賞受賞企業（オーミハイテク㈱製造部部長） 角田 和哉　第3回JPCAものづくり大賞受賞企業（三和電子㈱生産管理課課長）	14:45-15:30	【特別講演7】経営者に見える現場改善効果「現場改善会計（GKC）」 柊 紫乃　愛知工業大学経営学部経営学科　教授
15:30-16:30	いま振り返るデミング博士の渾身の教え ～デミング博士著作Out of The Crisis初日本語版刊行記念～ 成沢 俊子　ピーキューブ㈱　代表取締役社長	15:10-15:55	【特別講演3】トヨタ式現場管理 田中 正知　ものづくり大学名誉教授／J-コスト研究所代表	15:30-16:00	JPCAものづくり大賞受賞改善取組み 事例報告 株 和教　第4回JPCAものづくり大賞受賞企業（太陽インキ製造㈱製造技術部工程技術課） 三井 卓也　第5回JPCAものづくり大賞受賞企業（㈱愛工機器製作所コア加工事業部技術G主査）
		15:55-16:40	【特別講演4】現場改善のJコスト理論による強化策（ROA） 田中 正知　ものづくり大学名誉教授／J-コスト研究所代表		

来場のご案内

電子機器トータルソリューション展は**WEB登録制**となります。**事前にWEBにて登録**をお願い致します。
本招待状をお持ちいただいただけでは入場できませんのでご注意ください。

STEP.1	STEP.2	STEP.3
公式ホームページより来場登録へお進みください	ご登録いただいたメールアドレス宛に、「来場者証」のPDFが添付された登録完了メールが届きます。登録完了メールが届かない場合は事務局までお問合せください。	展示会当日、登録完了メールに添付されている「来場者証」をプリントアウトし、四つ折りの状態でご持参ください。バッジケースをピックアップ頂き、来場者証を中に入れ、会場入り口にてバーコードをご提示ください。

公式HPはこちら
最新情報はHPをご覧ください

来場者参加企画：ブースコンテスト

来場者参加型企画として昨年実施いたしましたブースコンテストを今年も開催！【ナイスデザイン賞】・【ベスト展示賞】・【特別賞】に値する出展ブースを皆様の投票で決定します。
投票していただいた皆様へは粗品を進呈いたします。
ぜひご参加ください。

来場者参加企画：スタンプラリー

電子機器トータルソリューション展スポンサー企業ブースを全社訪問するとオリジナルグッズがもらえるスタンプラリーを開催します!
台紙は会場にてお配りいたしますので、ぜひブース訪問してください。

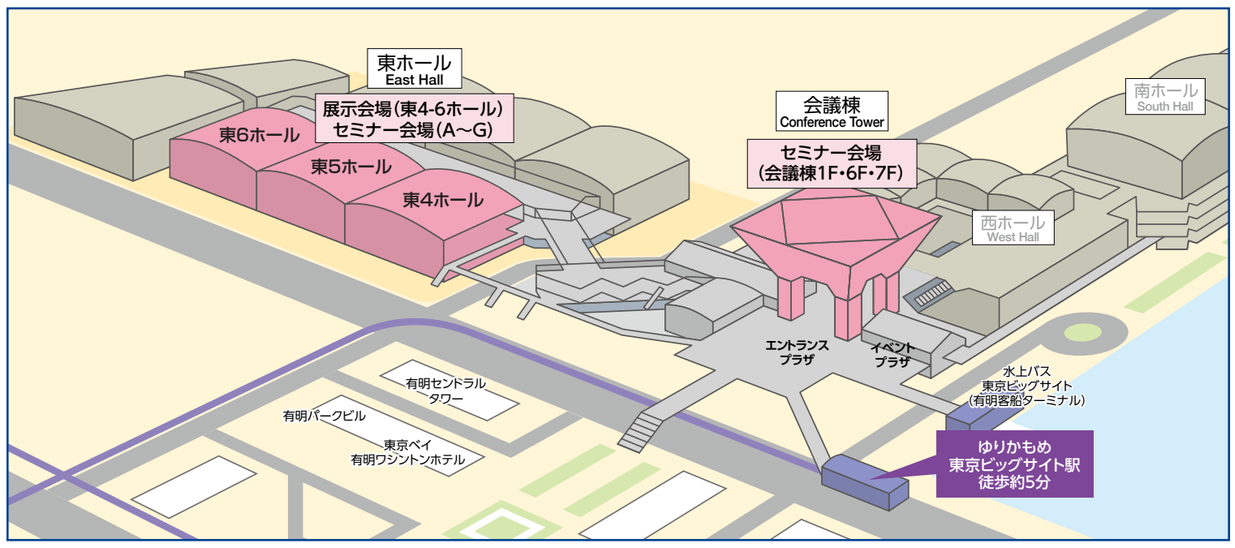
ヨロズ相談室　無料　展示ホール内

来場者の皆様からの技術的な相談、インターネットでは聞けない疑問等にJPCAコンサルタントがお答えします。
電子回路（基板・実装・材料）、専門加工、製造装置、センサ等の技術に関すること、活用方法がわからない方、ヨロズ相談室でぜひご相談ください。

本展では、コロナ対策を徹底の上、開催いたします。
ご来場の皆様には感染症対策を徹底いただき、ご来場予定当日に体調不良の場合はご来場をお控えいただきますようお願いします。

マスクの着用／検温の実施／ソーシャルディスタンス／手指消毒／咳エチケット／大きな声で会話／訪問先の記録／換気の実施／こまめな手洗い／分散来場／余裕を持ったレイアウト／三密の回避

会場マップ



JARA創立50周年記念セミナー　無料

展示会へご来場の方はどなたでも聴講いただけます。事前の聴講申込が必要です。　**会議棟1階 101会議室**

聴講のお申込みはJISSO PROTEC のHPからお願いします **https://www.jissoprotec.jp**

	6月15日（水）	6月16日（木）	6月17日（金）
	スマート化（工場、製造ライン、物流）	実装技術の最新動向（実装設備、接合材料、電子部品）	SMT業界をとりまく世界の変化（DX・IoT、新エネルギー車）
10:30～11:30	安川電機が進めるDXとものづくりの変化への対応 ～『YDX（YASKAWAデジタルトランスフォーメーション）』と『i³-Mechatronics（アイキューブ メカトロニクス）』の活動事例～ 小笠原 浩　㈱安川電機　代表取締役会長兼社長	2022年度版JEITA実装技術ロードマップの紹介 ～実装設備を中心に～ 前田 憲　パナソニック コネクト㈱　プロセスオートメーション事業部　JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会　実装設備WG 主査	三菱電機のデジタルマニュファクチュアリング ～技術革新によるサステナブルな社会の実現～ 楠 和浩　三菱電機㈱　FAシステム事業本部　役員技監
13:15～14:15	企業の垣根を越えた取組 SMTのスマート化を推進する新しいグローバル通信標準 SEMI Flow Manufacturing（FM）Forum	CASE時代に求められる接合材料・実装技術 神谷 有弘　㈱デンソー　電子PFハードウェア開発部　JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会　客員　JIEP部品内蔵技術委員会　委員	中国EVシフトの現在地 湯 進　上海工程技術大学　客員教授
14:45～15:45	スマートロジスティクス®～LogisticsからLOGISTEED®へ 長尾 清志　㈱日立物流　執行役常務　営業統括本部長　兼 ロジスティクスソリューション開発本部長　兼 輸送事業強化PJ長	電子部品の最新技術動向 加藤 喜文　JEITA 電子部品部会・部品技術ロードマップ専門委員会　主査 谷本 琢磨　JEITA 電子部品部会・部品技術ロードマップ専門委員会　メンバー	

PROTECセミナー　無料　**会議棟7階 703会議室**

聴講申込方法はJISSO PROTEC のHPよりご確認ください **https://www.jissoprotec.jp**

6月15日（水）	10:30-11:30	実装・アセンブリに貢献するMUSASHIのディスペンス技術　大岡 正典　武蔵エンジニアリング㈱　マーケティング戦略本部　統括課長
	12:00-13:00	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2022　川井 建三　ヤマハ発動機㈱　ロボティクス事業部　営業統括部　SMT国内営業部　SPグループ　グループリーダー
	13:30-14:30	5Gがもたらす実装課題に対応するモノづくり最前線　武野 祐丸　㈱FUJI　営業技術部　第2営業技術課　課長
	15:00-16:00	進化する知能で実現するAutonomous Factory　馬渡 道明　パナソニック コネクト㈱　プロセスオートメーション事業部　回路形成プロセス事業担当　回路形成プロセス開発総括部　システムソリューション開発部　開発4課　課長
6月16日（木）	10:30-11:30	進化する知能で実現するAutonomous Factory　馬渡 道明　パナソニック コネクト㈱　プロセスオートメーション事業部　回路形成プロセス事業担当　回路形成プロセス開発総括部　システムソリューション開発部　開発4課　課長
	12:00-13:00	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2022　川井 建三　ヤマハ発動機㈱　ロボティクス事業部　営業統括部　SMT国内営業部　SPグループ　グループリーダー
	13:30-14:30	前後工程の自動化による効率化と最新SMTソリューションのご提案　JUKI㈱
	15:00-16:00	FSF2.0　進化するスマートファクトリー　加藤 大輔　㈱FUJI　第一ソフト技術部　部長
6月17日（金）	10:30-11:30	SMT後工程の自動化　石川 信幸　㈱FUJI　第四営業部　第2営業課　課長
	12:00-13:00	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2022　川井 建三　ヤマハ発動機㈱　ロボティクス事業部　営業統括部　SMT国内営業部　SPグループ　グループリーダー
	13:30-14:30	進化する知能で実現するAutonomous Factory　馬渡 道明　パナソニック コネクト㈱　プロセスオートメーション事業部　回路形成プロセス事業担当　回路形成プロセス開発総括部　システムソリューション開発部　開発4課　課長
	15:00-16:00	～実装変動の知見から生み出される～ 最先端検査技術と品質システム　杉山 俊幸　オムロン㈱

熱関連セミナー　無料　事前登録不要　**会議棟6階　610会議室**

	6月17日（金）
13:00-14:00	調整中 鈴木 康一　山口東京理科大学　名誉教授 畠山 友行　富山県立大学　准教授

製品安全セミナー　無料　事前登録不要　**会議棟6階　610会議室**

	6月16日（木）
13:30-14:30	製品安全セミナー 榧場 正男　㈱カヤバオフィス　代表取締役

ロードマップセミナー　有料　要事前登録　**会議棟7階　701+702会議室**

	6月16日（木）
13:00-13:50	最新半導体パッケージ技術動向 宇都宮 久修　インターコネクション・テクノロジーズ㈱
14:00-14:30	最新半導体市場動向 山本 義継　みずほ証券㈱
14:30-15:00	最新機能集積配線板技術動向 横内 貴志男
15:10-16:00	最新高速通信機器システム 西尾 俊彦　㈱SBRテクノロジー
16:10-17:00	最新高速通信機器用プリント基板 飯長 裕　OKIサーキットテクノロジー㈱

ぷりんとばんじゅくセミナー　無料　事前登録不要　**会議棟6階　609会議室**

	6月15日（水）
11:00-12:00	プリント配線板全般の基礎“ぷりんとばんじゅくI”をもとに解説 榧場 正男　㈱カヤバオフィス　代表取締役
13:00-14:00	プリント配線板設計の基礎“ぷりんとばんじゅくII”をもとに解説 田中 弘文
14:30-15:30	フレキシブル配線板の基礎“ぷりんとばんじゅくVII”をもとに解説 宮崎 博明　MFインフォメーション㈱　代表取締役
	6月17日（金）
11:00-12:00	実装の基礎“ぷりんとばんじゅくV”をもとに解説 榧場 正男　㈱カヤバオフィス　代表取締役
13:00-14:00	品質管理の基礎 安井 博文　安井事務所　PWBコンサルタント

日本の電子回路産業発行報告会　無料　事前登録不要　**会議棟6階　610会議室**

	6月16日（木）
10:15-11:15	電子回路産業の現状と将来展望について 萩原 徹　（一社）日本電子回路工業会　調査担当

PWBコンサルタントスキルアップセミナー　無料　要事前登録　**会議棟6階　609会議室**

	6月17日（金）
15:00-16:45	PWBコンサルタントスキルアップセミナー 対象　PWBコンサルタント、PWBインストラクタ 1級・準1級資格保有者の方のみ ※別途事前申込が必要です 安井 博文　安井事務所　PWBコンサルタント

※本招待状に掲載のプログラム他は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は早目の受付にご協力お願いいたします。

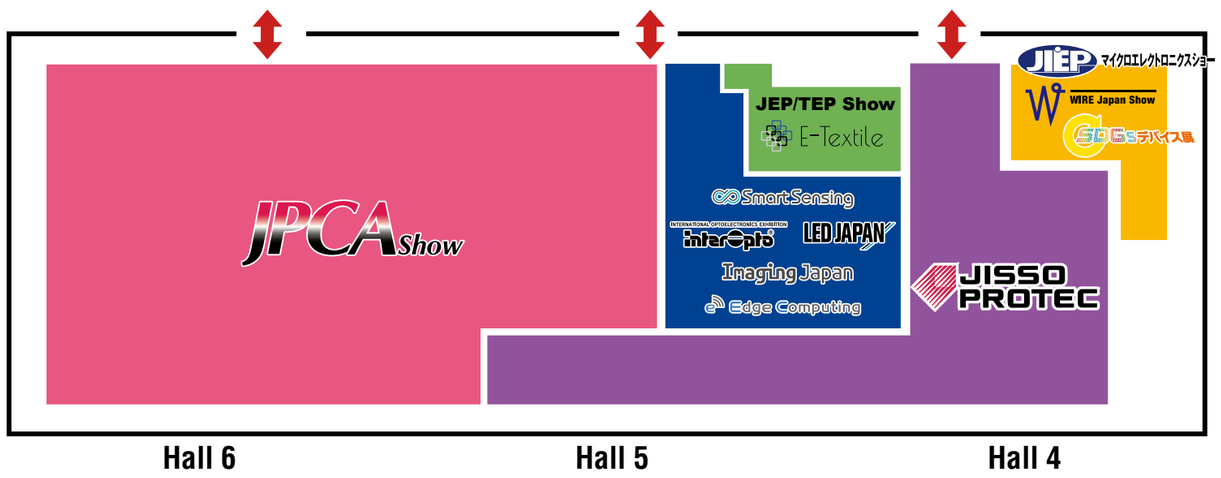
出展者（NPI）プレゼンテーション 無料　展示ホール E会場／F会場

		展示ホール E会場 NPIセミナー会場①	展示ホール F会場 NPIセミナー会場②
6月15日（水）	13:35-13:55	高周波化対応次世代BTレジン材料の紹介 三菱ガス化学㈱	ますます重要になっていく基板クリーナーにおける静電気制御 ㈱ブルックスジャパン
	14:15-14:35	シミュレーションとAIでプリント基板設計に革命 ㈱オンテック	SLM（液晶空間光変調器）とそのアプリケーション応用：米国メドラークオプティクス社製SLMの最新動向とアプリケーション事例につきご紹介いたします。 フォトテクニカ㈱
	14:55-15:15	世界最先端のUVセンサ技術とその応用（監修：sglux GmbH） ㈱アイ・アール・システム	一括混載実装に対応するはんだ印刷マスク用レーザー加工技術と 微細加工分野への応用 ㈱ブルックスジャパン
	15:35-15:55	高性能有機半導体技術を利用したフィルムセンサが実現するスマート社会 パイクリスタル㈱	
6月16日（木）	10:55-11:15	あらゆる測定器を同時監視!ソフトウェア開発歴24年の実績と実力で挑む、 IoT技術の新たな付加価値。 ㈱ソフトエイジェンシー	日立ハイテクサイエンスが提供するプリント基板の評価・分析技術紹介 ㈱日立ハイテクサイエンス
	11:35-11:55	Beyond 5G向け めっきプロセスのご提案 ㈱JCU	部品実装工程におけるCAD/CAMデータを活用したダイナトロン実装ソリューション ダイナトロン㈱
	12:15-12:35	レーザアブレーション加工機によるポリイミド、フッ素樹脂フィルムの高品質加工 澁谷工業㈱	“InShop® 装置データ集計・検証システム” 新バージョンとロードマップのご紹介 日本オルボテック㈱
	12:55-13:15	高弾性・低熱膨張プリント配線板用材料MCL-E-795Gのご紹介 昭和電工マテリアルズ㈱	
	13:35-13:55	プリンテッドデバイスの開発事例紹介 ㈱ダイセル	注目の出展者プレゼン（仮） interOpto出展者
	14:15-14:35	薄膜密着強度測定機Romulus紹介 フォトテクニカ㈱	注目の出展者プレゼン（仮） interOpto出展者
	14:55-15:15	半世紀で培った不織布製法で○○○が可能になる研磨ホイール 金井重要工業㈱	薄膜～厚膜、全面～部分塗布 INK JET技術のご紹介 ㈱石井表記
	15:35-15:55	ZEISS非破壊3D高分解能イメージング X線顕微鏡のご紹介_xOOB_ 【Electronics編】 カールツァイス㈱	高品質・量産対応の革新的ロールtoロール式DI機 ”Infinitum” とUVレーザードリル機 “Apeiron” のご紹介 日本オルボテック㈱
6月17日（金）	10:55-11:15	液晶光配向膜を用いた幾何学位相素子形成とその応用 国立大学法人 長岡技術科学大学 電磁波・光波制御研究グループ	
	11:35-11:55	分光と言えば HORIBA ～OEMグレーティング&分光器のカスタマイズ事例～ ㈱堀場製作所	
	12:15-12:35	ガラス基板への無電解銅めっきプロセス「PLOPXプロセス」 奥野製薬工業㈱	
	12:55-13:15	ドイツTier 1が認めたLPKF PWBレーザーカット（デパネリング）テクノロジー LPKF Laser&Electronics㈱	日立ハイテクサイエンスが提供するプリント基板の評価・分析技術紹介 ㈱日立ハイテクサイエンス
	13:35-13:55	シミュレーションとAIでプリント基板設計に革命 ㈱オンテック	水平型ロールtoロールめっき装置対応 高ビアフィリング硫酸銅めっき添加剤「トップルチナSVP」 水平型ロールtoロールめっき装置の課題を克服 良好なビアフィリング性を発揮する硫酸銅めっき添加剤「トップルチナSVP」 奥野製薬工業㈱
	14:15-14:35	Zeiss非破壊3D高分解能イメージング X線顕微鏡のご紹介【Electronics編】 カールツァイス㈱	2次元FTIR分光装置の応用 ㈱日進機械
	14:55-15:15	「回路シュミレータ LTspiceで学ぶ電子回路」著者 渋谷道雄による LTspiceセミナー ㈱三共社	その不具合、樹脂が原因では?温度・湿度コントロール下での材料分析による 樹脂特性の理解 ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン㈱
	15:35-15:55	「回路シュミレータ LTspiceで学ぶ電子回路」著者 渋谷道雄による LTspiceセミナー ㈱三共社	
	16:15-16:35	「回路シュミレータ LTspiceで学ぶ電子回路」著者 渋谷道雄による LTspiceセミナー ㈱三共社	

2022年度 OITDAセミナー「サイバー・フィジカル社会の実現に向けた光技術」 無料 要事前登録　会議棟1階 102会議室

	6月15日（水）
10:25-10:30	主催者挨拶 小谷 泰久 （一財）光産業技術振興協会 副理事長 兼 専務理事
10:30-11:15	ダイナミックイメージコントロールの新展開 奥 寛雅 国立大学法人 群馬大学 情報学部 教授
11:15-12:00	人と機械が協調する社会の実現に向けた画像センシング技術 木下 航一 オムロン㈱ 技術・知財本部 アドバンストテクノロジーセンター アドバンストテクノロジー開発部 技術専門職
12:00-13:00	（昼食休憩）
13:00-13:45	人に優しい裸眼3Dディスプレイと遠隔コミュニケーションへの応用 高田 英明 国立大学法人 長崎大学 情報データ科学部 教授
13:45-14:30	メタバースとVR技術がもたらす社会変化 岩城 進之介 ㈱バーチャルキャスト 取締役CTO

展示ホール内ゾーニング（2022年4月13日（水）現在）



Smart Sensing 2022 Innovation Summit 無料 要事前登録　展示ホール C会場

Keynote Speech

	6月15日（水）
11:25-12:15	「変える力」と「つなぐ力」でIoT実装に革命を 平田 勝則 コネクテックジャパン㈱ 代表取締役 CEO

	6月16日（木）
10:15-11:05	バーチャルエコノミー拡大に向けたスマートセンシング 持丸 正明 （国研）産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長

企業プレゼンテーション

	6月16日（木）
14:30-15:10	多品種変量時代にはビジネスモデルで戦う"半導体実装開発に付加価値あり" 安藤 守 コネクテックジャパン㈱ 営業開発本部 取締役

	6月17日（金）
15:30-16:10	「世界ロボットビジネス大全」発行記念セミナー 日本のロボットビジネスの「価値筋」 小林 賢一 NPO法人ロボティック普及促進センター 理事長 ㈱ロボットメディア 代表取締役

JIEPアカデミックプラザ 無料 事前登録不要　展示ホール G会場

	6月16日（木）	6月17日（金）
13:00-13:25	昇温脱離分析装置（TDS）によるめっき膜や複合材料の分析 関東学院大学／電子科学㈱	負の透磁率材料を用いた伝送線路の表皮効果損失抑制に対する異方性磁界の影響 長野工業高等専門学校
13:25-13:50	塩化カルシウム濃厚水溶液を用いた電気めっき法によるモリブデン薄膜の作製 関東学院大学大学院／フォトテクニカ㈱	ワイヤーグリッド付きITO透明導電膜で形成するマイクロストリップ線路の 伝送特性の検討 東京工芸大学
13:50-14:15	有機溶媒中におけるアルミニウム電析めっきとスカンジウム塩化物微量添加効果 関東学院大学大学院／沖エンジニアリング㈱	腕部上に配置する通信用ウェアラブルスパイラルコイルの変形に対する伝送特性の検討 東京工芸大学
14:15-14:40	銅系導電性ペーストの材料開発の確立を目指した界面化学現象と 電気伝導特性発達挙動の解析 群馬大学	コイルを用いた血管の膨張・収縮センサによる心拍検出の検討 東京工芸大学大学院
14:40-15:05	インモールド・エレクトロニクスへの応用を目指したストレッチャブル印刷配線の 立体成形中の電気伝導特性制御 群馬大学大学院	胴体表面に配置されたウェアラブル電極を用いる人体通信の伝送特性の検討 東京工芸大学
15:05-15:20	休憩	
15:20-15:45	高速度ビデオモニタの診断に基づくCuダイレクトレーザバイアホール加工複数 パルス照射の最適化 同志社大学大学院	経皮エネルギー伝送用コイルの円筒曲面変形に対する伝送特性の検討 東京工芸大学大学院
15:45-16:10	マイクロドリル工具のカタログマイニングにおけるファジィクラスタリングの 有用性についての検討 同志社大学／岡山大学	4周波遮断帯域を有するUWB用半円台形不平衡ダイポールアンテナ 東京工芸大学
16:10-16:35	Beyond-MHzスイッチング電源用プレーナ型EMIフィルタの開発 信州大学	遅延故障検査容易化バウンダリスキャンにおける観測対象判別回路による検査時間短縮 徳島大学大学院
16:35-17:00	GHz帯用広帯域左手系疑似伝送線路型薄膜コモンモードフィルタの開発 信州大学／長野工業高等専門学校	

テラヘルツテクノロジーフォーラム 無料 要事前登録
第14回テラヘルツビジネスセミナー（14th THz-biz）　展示ホール C会場

	6月15日（水）
13:00-15:30	調整中

All about Photonics主催者セミナー 無料 要事前登録
光半導体最新セミナー　展示ホール C会場

	6月16日（木）
12:45-13:10	LD/LEDによる偏光を利用した画像計測・分光計測技術の開発 江本 顕雄 国立大学法人 徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 特任講師
13:15-13:40	新しい応用分野を切り拓く産業用LEDの紹介と 新たな用途展開の可能性について（仮） Luminus Devices / 丸文㈱
13:45-14:10	調整中

応用物理学会フォトニクス分科会ミニセミナー
無料 事前登録不要　展示ホール C会場

	6月17日（金）
13:00-13:15	はじめに：「フォトニクス分科会の紹介」
13:15-13:50	高感度環境分光計の進展 ～温室効果ガスから自動車排出ガスまで～（仮） 戸野倉 賢一 国立大学法人 東京大学 教授
13:50-14:25	有機半導体界面を舞台にした高効率光エネルギー変換（仮） 伊澤 誠一郎 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所 助教授
14:25-15:00	プラスチックリサイクルに貢献する分光技術（仮） 瀧美 利久 浜松ホトニクス㈱

3D-MIDパビリオンセミナー 無料　展示ホール D会場

	6月15日（水）
10:30-11:00	『共同公演』MID設計～レジスト～自動実装 北郷 和英 大英エレクトロニクス㈱
11:20-11:50	MIDの概要と、日本MID協会の活動紹介 松澤 浩彦 日本MID協会 幹事

	6月16日（木）
10:30-11:00	触媒失活材料を用いた新規MID技術とその応用 浅見 明子 マクセル㈱
12:10-12:40	MIDの概要と、日本MID協会の活動紹介 松澤 浩彦 日本MID協会 幹事
13:00-13:30	ヱビナ電化工業㈱のLDS事業の取り組み 秋山 賢二 ヱビナ電化工業㈱ 技術営業部 係長

	6月17日（金）
10:30-11:00	MIDの概要と、日本MID協会の活動紹介 松澤 浩彦 日本MID協会 幹事
11:20-11:50	3D-MIDのためのエレメカ協調設計環境 松澤 浩彦 ㈱図研 技術本部EL開発部 シニア・パートナー

JEP/TEPセミナー 無料　展示ホール D会場

	6月16日（木）
11:20-11:50	製造現場・社会インフラの課題を解決するAIソリューション 中捨 隆弘 東亜無線電機㈱ 開発営業部 次長

E-Textile Initiativeセミナー
無料 事前登録不要　展示ホール D会場

	6月17日（金）
14:00-16:00	調整中

優れた製品・技術内容や、新製品・新技術を促進させて展示会に活力を与え、総合的な技術の進歩発展を図っている出展者を表彰します。

JPCA Show AWARDS 2022 授賞式

表彰式日時・会場についてはHPをご確認ください

半導体オブ・ザ・イヤー 2022

半導体オブ・ザ・イヤー2022
受賞製品・技術発表

6月15日（水）14:00～17:00
（受付開始13：30～）
於・会議棟6階 610会議室

出展者一覧

2022年4月13日（水）現在 （展示会別・50音順）

スポンサー企業

プラチナ
メイコー

ゴールド
アトテックジャパン
イー・エス・アイ・ジャパン
FICT
ダイナトロン
太陽インキ製造
日本オルボテック
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン
メック

シルバー
京写
松和産業

ブロンズ
ニッカン工業

JPCA Show

プリント配線板技術展
アドテックエンジニアリング
アトテックジャパン
アポロ精工
アルテアエンジニアリング
イー・エス・アイ・ジャパン
ECI JAPAN
石井表記
石原ケミカル
イチカワテクノファブリクス
伊原電子工業
インスペック
上村工業
エイト工業
FICT
エムシーケー
LPKF Laser&Electronics
オーク製作所
大船企業日本
オカダジーエージェイ
奥野製薬工業
オンテック
科学情報出版
金井重要工業
北川精機
協栄プリント技研
京写
熊本県庁
クラボウ
ケミトロン
ケンマージャパン
サーマプレシジョン
相模ピーシーアイ
サクラクレパス
三晃技研工業
J-RAS
JCU
四会富仕電子科技股份有限公司
四国化成工業
澁谷工業
JADASON Enterprises
松和産業
昭和電工マテリアルズ
シライ電子工業
伸光製作所
深圳市ニューセス実業
ステラ・コーポレーション
ソマール
ダイナトロン
大日光・エンジニアリング
太陽インキ製造
ダイワ
ダイワ工業
タカノ
タケウチ
チューリップ
角田ブラシ製作所
テスプロ
電子回路企業年金基金
東京マシン・アンド・ツール
東洋鋼鈑
東洋紡
ニッカン工業
日刊工業新聞社
日放電子
日本アグフアマテリアルズ
日本エバレット・チャールス
日本オルボテック
日本テルペン化学
日本電産リード
日本電子回路工業会（JPCA）
野田スクリーン
ハイロックス
伯東
PAN-TEC
ビアメカニクス
日立ハイテクサイエンス
HWAIN TRADING
フィッシャー・インストルメンツ
福田金属箔粉工業
フジプリグループ
藤森工業
ブルックスジャパン
ベアック
マイクロクラフト
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン
マコー
三菱ガス化学
三菱電機
メイコー
名東電産
メック
モトロニクス
ユニオン ツール
レヨーン工業
Rogers Japan

3D-MIDパビリオン
ヱビナ電化工業
三恵技研工業
図研
大英エレクトロニクス
太陽インキ製造
日本MID協会
マクセル

半導体パッケージング・部品内蔵技術展
ウシオ電機
AJ
大阪ソーダ
清川メッキ工業
内藤電誠工業
長瀬産業
日本電気硝子
日本ミクロン

フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
沖電線
デンカ
八光電子工業
山下マテリアル
ユアサシステム機器

機器・半導体受託生産システム展
アソビクス
富士電子
ヤマキ電気

マイクロエレクトロニクスショー
Addison Clear Wave Coating
エレクトロニクス実装学会（JIEP）
ダイセル
和光電気

eX-tech
秋田化学工業
アテネ
アンドールシステムサポート
イープロニクス
エスペック
大阪有機化学工業
Shimada Appli
ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン
日邦産業
プラズマイオンアシスト
堀内電機製作所

アカデミックプラザ
愛媛大学大学院 理工学研究科
大阪産業技術研究所
大阪大学
関東学院大学大学院
関東学院大学 理工学部 小岩研究室
京都大学
群馬大学
信州大学 工学部 電子情報システム工学科
先端磁気デバイス（佐藤・曽根原）研究室
東海大学
東京工芸大学
徳島大学大学院 社会産業理工学研究部
長野工業高等専門学校
日本大学
山形大学 YU-FIC

JISSO PROTEC
アユミ工業
アルファエレクトロニクス
イチネン製作所
ウイングビジョン
オムロン
カールツァイス
化研テック
川崎重工業
Gichoビジネスコミュニケーションズ
Cominix
サキコーポレーション
サヤカ
CKD
JUKI
ジュッツジャパン
昭立電気工業
シンアペックス
太洋電機産業
日本スペリア社
日本ミルテック
日本ロボット工業会（JARA）
博衆精工
パスコン
白光
パナソニック コネクト
FUJI
武蔵エンジニアリング
ヤマハ発動機
ユニテク

SDGsデバイス展
産業タイムズ社

WIRE Japan Show
工業通信
ミカドテクノス

JEP/TEP Show
アール電子
飯田通商
NNP
岡本無線電機
三共社
成電社
全国電子部品流通連合会（JEP）
大和無線電機
ツルタ制御機器
東亜無線電機
東京都電機卸商業協同組合（TEP）

E-Textile
繊研新聞社
米澤物産

Smart Sensing
アール・ティー・シー
アイ・アール・システム
YITOAマイクロテクノロジー
イノベーションリサーチ
SMK
エヌエスティ・グローバリスト
NTTアドバンステクノロジ
ガゾウ
金沢大学振動発電研究室
ケイエルブイ
光波
神戸デジタル・ラボ
コーンズ テクノロジー
コネクテックジャパン
産業技術総合研究所
情報処理学会ユビキタスコンピューティングシステム研究会
センサーズ・アンド・ワークス
ソフトエイジェンシー
泰興物産
タッチエンス
DIC
帝国インキ製造
デルタツーリング
東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室
東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター
東洋紡
ナノシード
ナルコーム
ピクシーダストテクノロジーズ
富士通
フジトク
ボールウェーブ
ホルトプラン
マイクロモジュールテクノロジー
マクセル
MODE, Inc.
リコー
ロボティック普及促進センター

All about Photonics
InterOpto/ LED Japan/ Imaging Japan
アイ・アール・システム
アイオーコア
アドコム・メディア
アンシス・ジャパン（旧 Zemax Japan）
エイム
応用物理学会 フォトニクス分科会
オプトロニクス社
Caeleste cv
京都光技術研究会
グラビトン
湖北工業
シナジーオプトシステムズ
スペースフォトン
スペクトルデザイン
住友電気工業
ゼータ・ブリッジ
太平貿易
千歳市／公立千歳科学技術大学
テラヘルツテクノロジーフォーラム
長岡技術科学大学 電磁波・光波制御研究グループ
日進機械
光産業技術振興協会（OITDA）
光産業創成大学院大学
光電子融合基盤技術研究所
光パスコミュニケーションズ
フォトテクニカ
物質・材料研究機構
プリンテッドエレクトロニクスグループ
堀場製作所
丸文
三ツ波
理化学研究所
レーザー輸入振興協会
レーザ協会
Laser Focus World Japan
レスターコミュニケーションズ
ロゼッタ

Edge Computing
アストロン